

B00 半孔测试针 规格书

编号：BKZ-B00-001

版本：B00 半孔测试针规格书_V1.0

日期：2023 年 7 月 4 日

版本历史记录

版本	时间	描述
1.0	2023/07/04	初始版本

目录

1、 概述.....	4
2、 功能特点.....	5
3、 应用场景.....	6
4、 使用说明.....	7

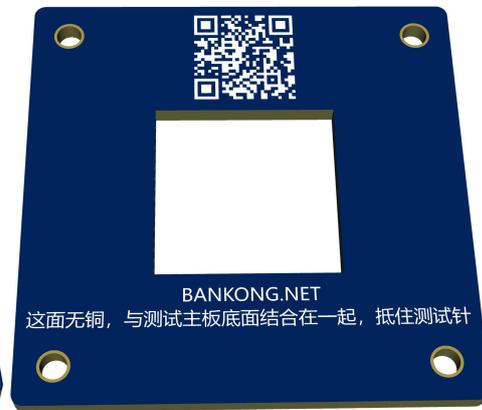
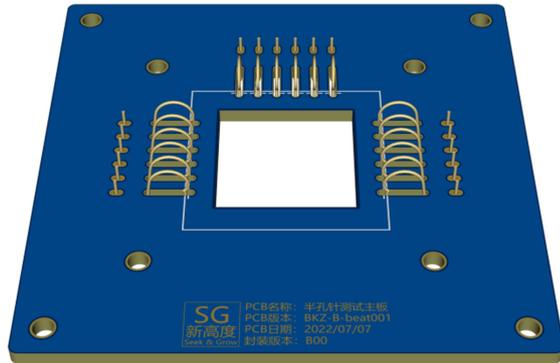
1、 概述

B00 半孔测试针可用于测试半孔或邮票孔形式封装的 PCB 板模块。

2、 功能特点

- 适用于：单边半孔模块、对边半孔模块、三边半孔模块；
- 材质：弹性钢；
- 线径：0.35mm；
- 表面处理：镀金；
- 自带定位结构：更利于安装及位置统一；
- **注意事项：因测试针受力方向原因，需要在测试板底部增加一块空板做为底板抵住测试针，防止受压变形；**

3、 应用场景



4、 使用说明

